

【証券コード：6728】

決算説明資料

2020年度上期

(2020年7月~2020年12月)

2021年2月15日

株式会社 アルバック

◆将来見通しに関する記述についての注意事項

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。

世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

◆本資料における表示方法について

(特段の記載がない限り、数値はすべて連結ベースです)

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

3Q (累計)： 第3四半期連結累計期間

3Q： 第3四半期連結会計期間

2020年度上期 連結業績概要

- 受注高・売上高ともに1Qを境に回復基調
- 上期受注高は当初予想を上回り、前年同期比でも大幅増加
- 売上高・営業利益も受注増加に伴い当初予想を上回る

〈上期実績〉

□ 受注高	910億円	(当初予想比 + 15.2%)
□ 売上高	838億円	(同上 + 7.5%)
□ 営業利益	58億円	(同上 + 6.3%)

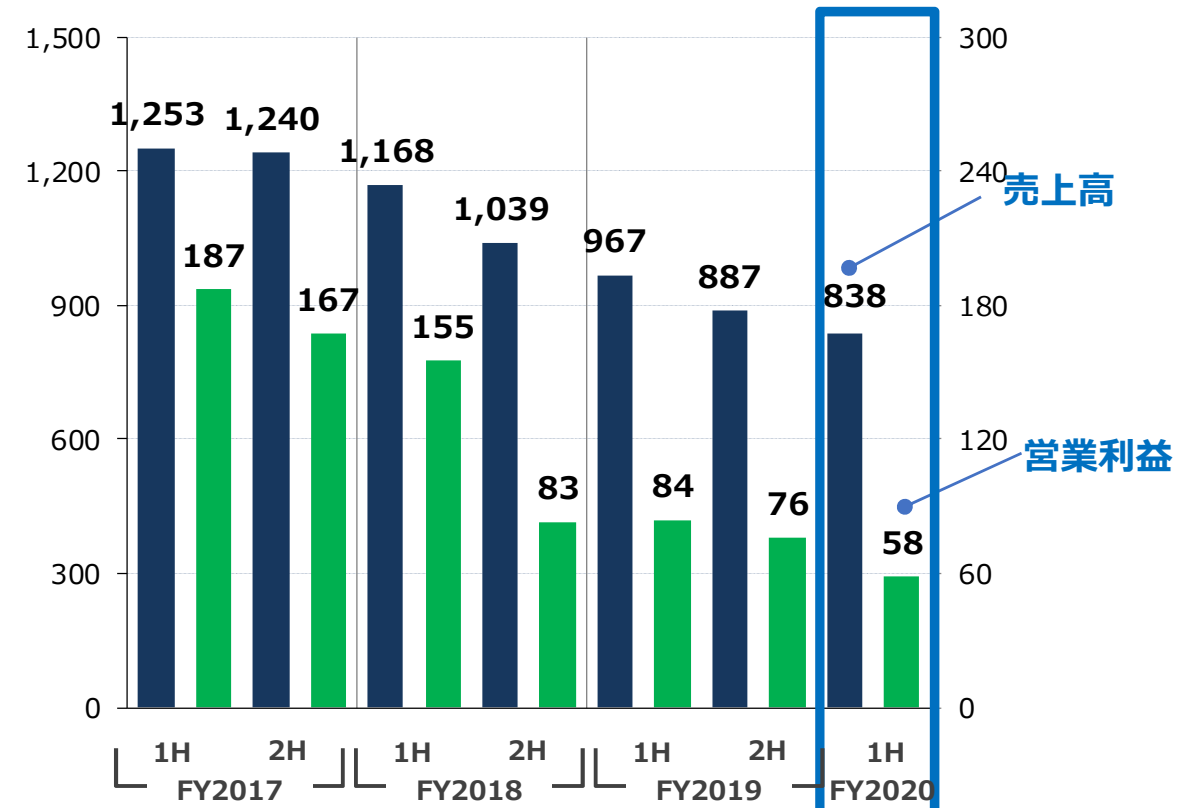
2020年度上期連結業績概要

- ・ 受注高：当初予想を上回り、前年同期比でも大幅増加
- ・ 売上高：受注増加に伴い当初予想を上回る
- ・ 営業利益：売上増加に伴い当初予想を上回る

【単位：億円】	(参考) 2019年度 上期実績	当初予想	2020年度上期		
			実績	対前年同期 増減率	当初予想比 増減率
受注高	720	790	910	26.4%	15.2%
売上高	967	780	838	-13.3%	7.5%
売上総利益	257	-	233	-9.1%	-
率	26.5%	-	27.8%	+ 1.3 pt	-
販管費	173	-	175	1.2%	-
営業利益	84	55	58	-30.3%	6.3%
率	8.7%	7.1%	7.0%	- 1.7 pt	- 0.1 pt
経常利益	99	60	60	-39.4%	-0.3%
率	10.3%	7.7%	7.2%	- 3.1 pt	- 0.5 pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	78	39	45	-41.7%	17.8%
率	8.0%	4.9%	5.4%	- 2.6 pt	+ 0.5 pt

売上高と営業利益の推移（半期毎）

【単位：億円】

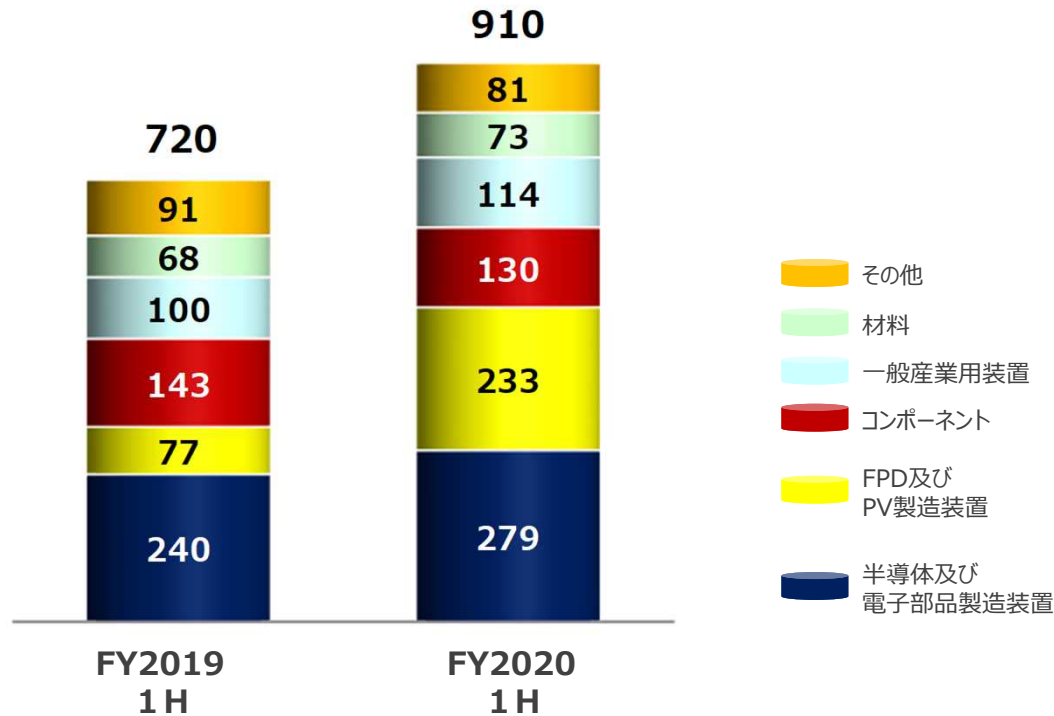


2020年度上期連結業績概要（品目別受注高）

- ・ 半導体・電子部品製造装置：当初想定していた受注回復に加え、3Q予定案件の2Q前倒し受注により、当初予想を上回り、前年同期比でも増加
- ・ FPD・PV製造装置：3Q予定だった中国大型TV用LCD案件の2Q前倒し受注により、当初予想を上回り、前年同期比でも大幅増加
- ・ コンポーネント：自動車関連の投資抑制等の影響もあり前年同期比減少

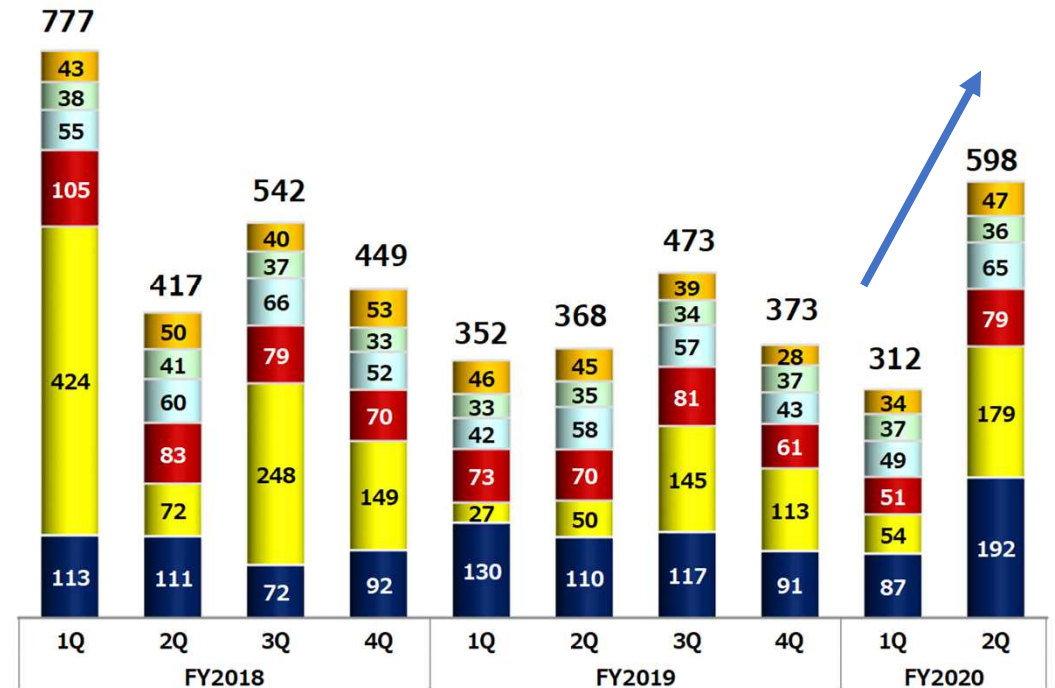
前年同期比

【単位：億円】



四半期推移

【単位：億円】

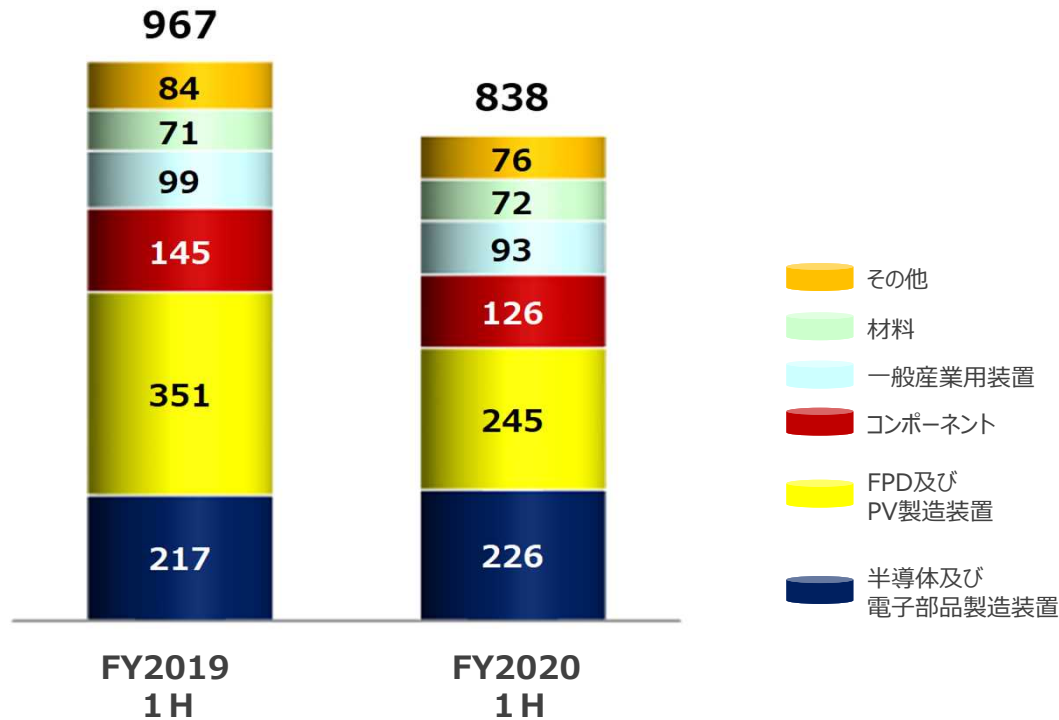


2020年度上期連結業績概要（品目別売上高）

- 売上高は19年度の受注高減少の影響により前年同期比減少
（四半期売上高は1Qを境に回復基調）

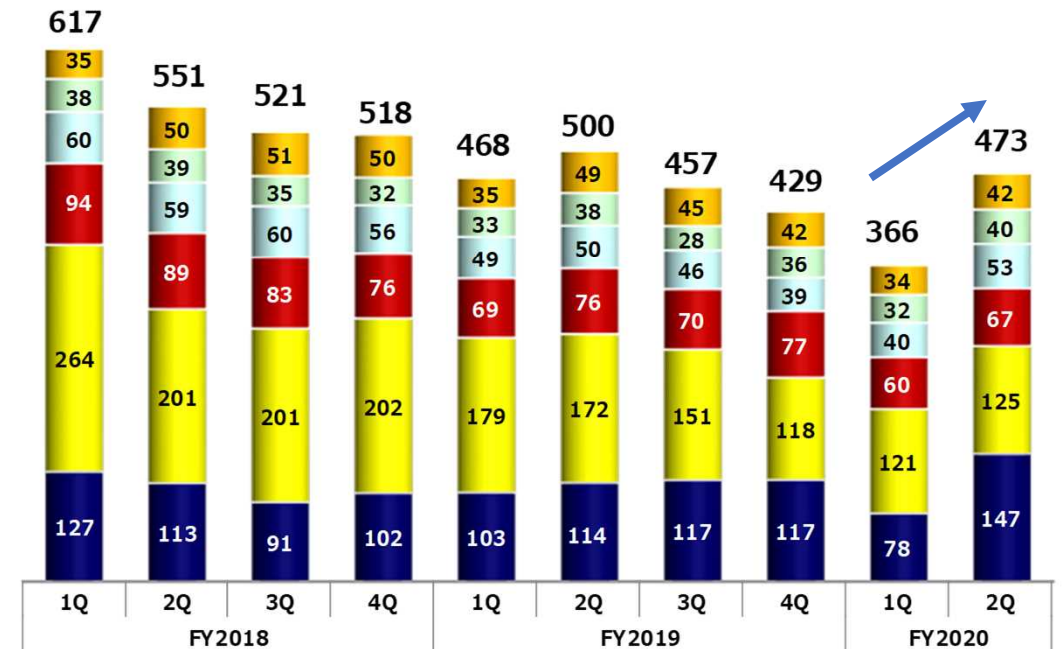
前年同期比

【単位：億円】



四半期推移

【単位：億円】

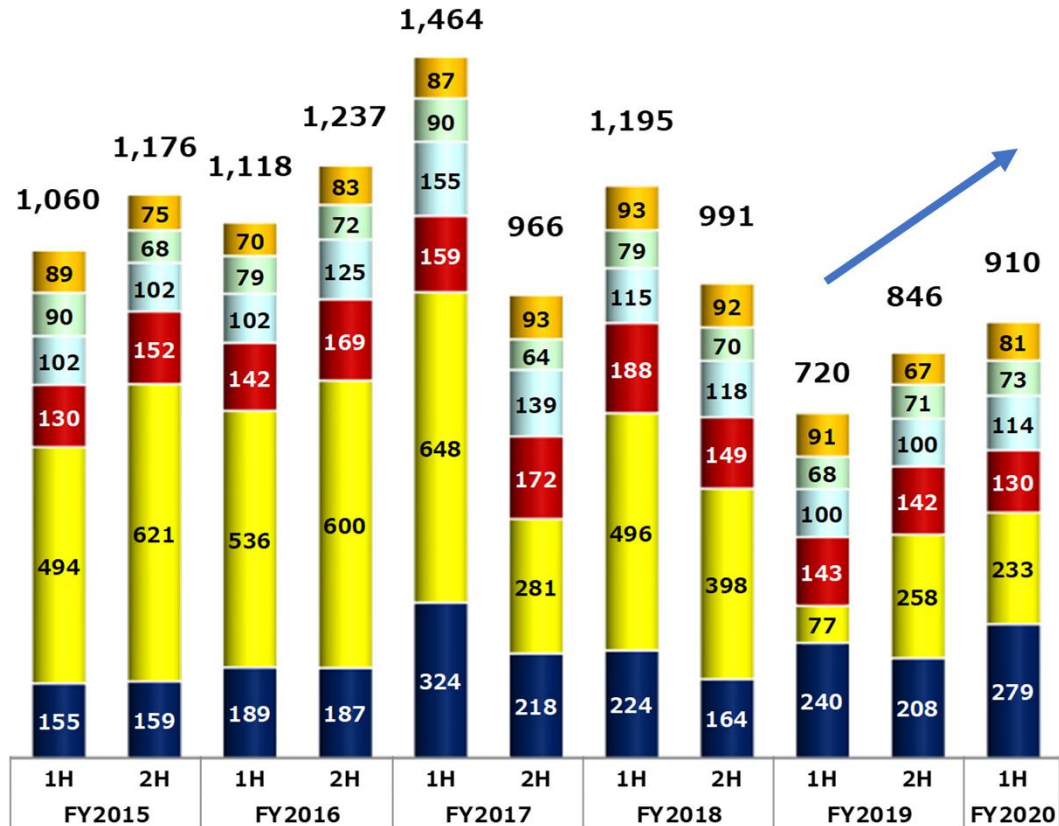


2020年度上期連結業績概要（品目別受注高・売上高 半期推移）

- ・ 受注高は19年度上期を境に回復基調（FPD・半導体電子が受注回復）
- ・ 売上高は19年度の受注高減少の影響により減少

受注高

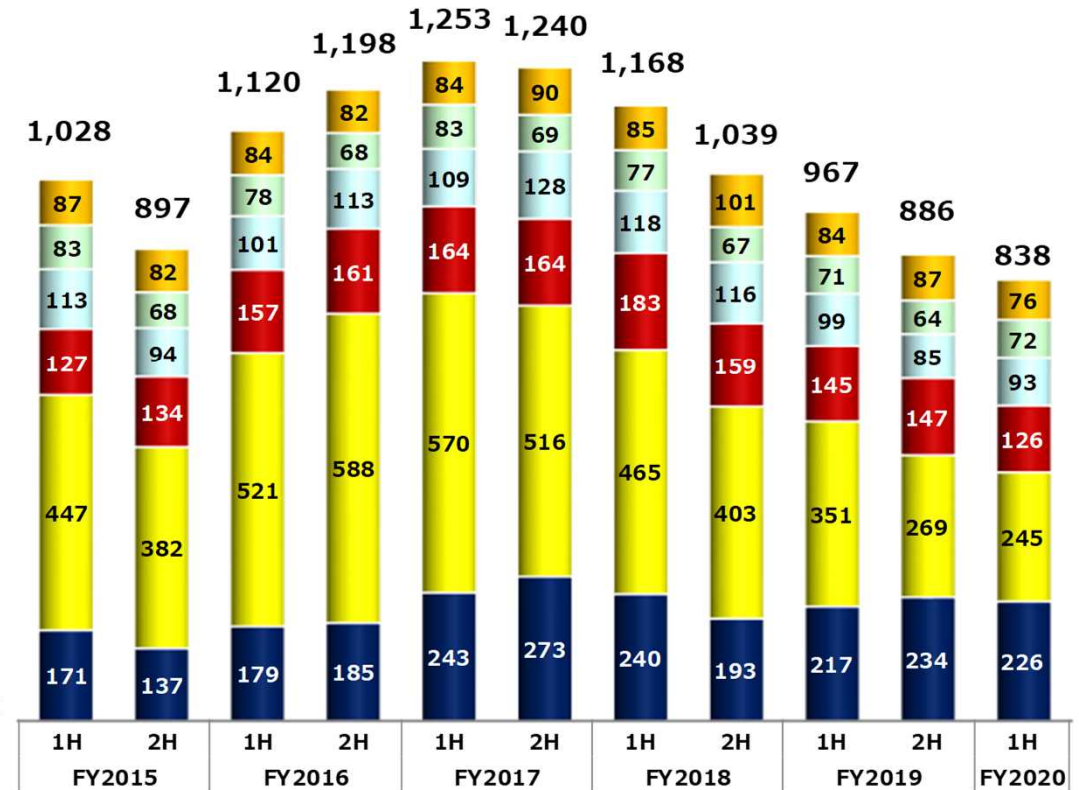
【単位：億円】



- その他
- 材料
- 一般産業用装置
- コンポーネント
- FPD及びPV製造装置
- 半導体及び電子部品製造装置

売上高

【単位：億円】

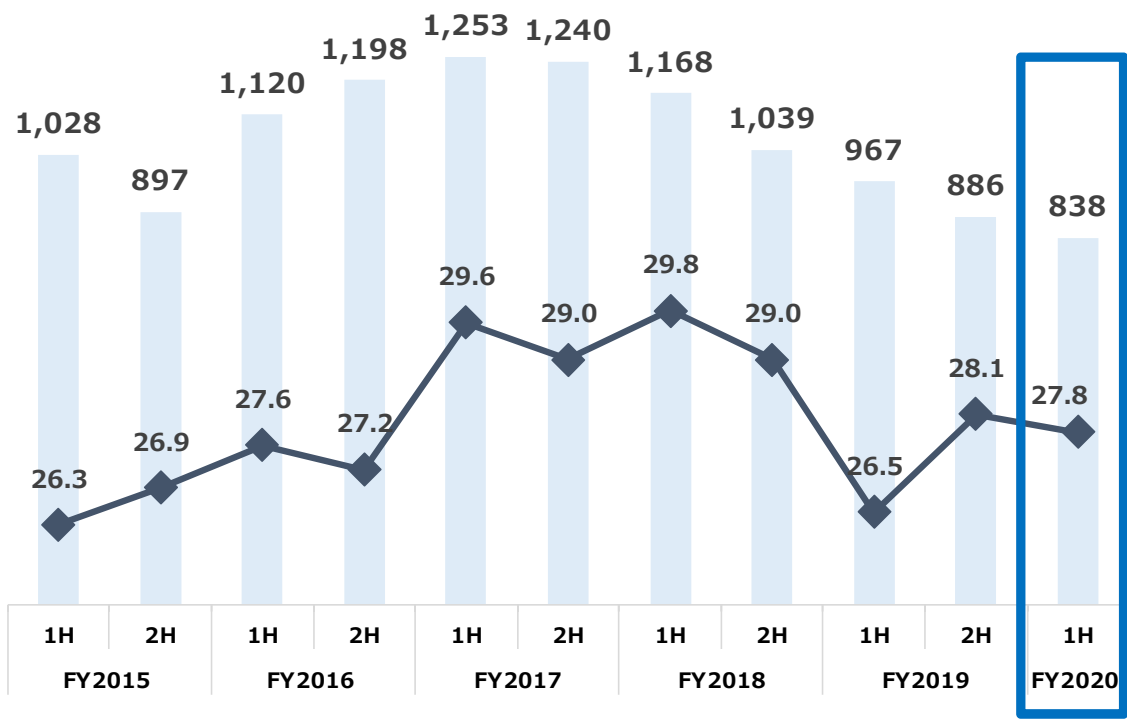


2020年度上期連結業績概要（利益率）

- ・ 売上高減少に伴い利益率も低下

売上総利益率

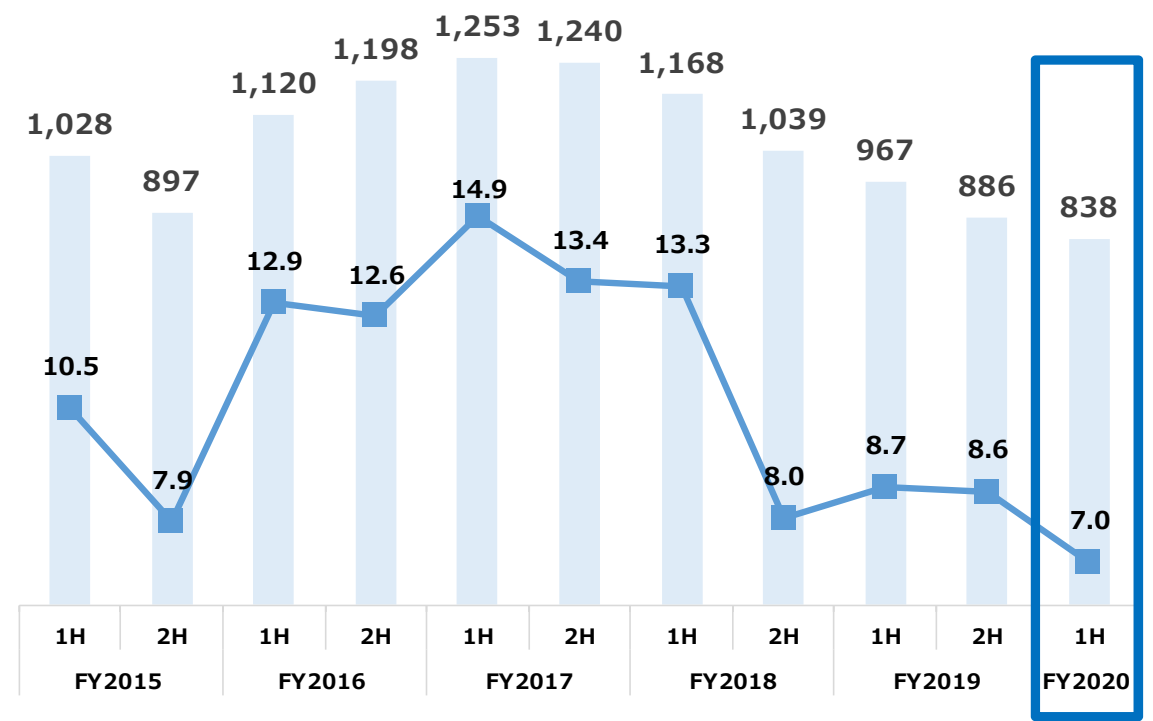
【単位：億円、%】



売上高

営業利益率

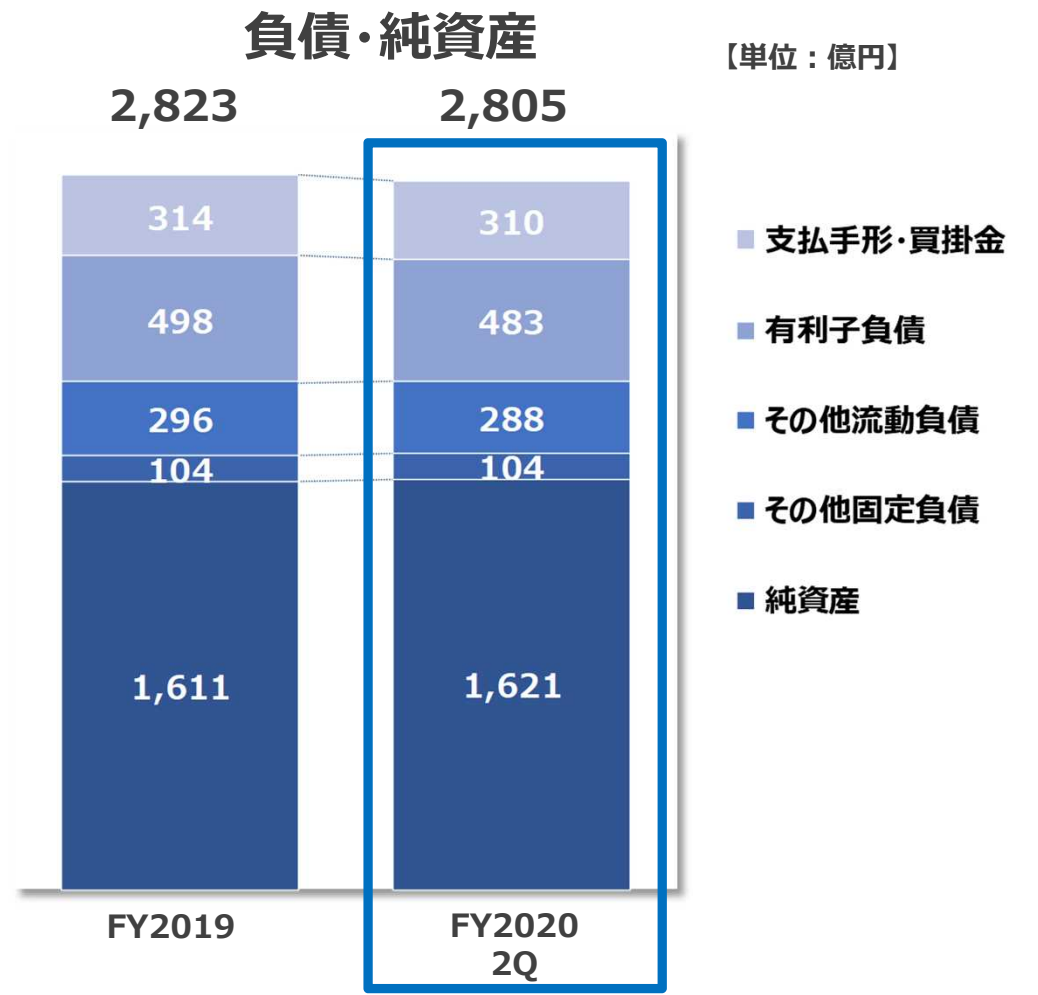
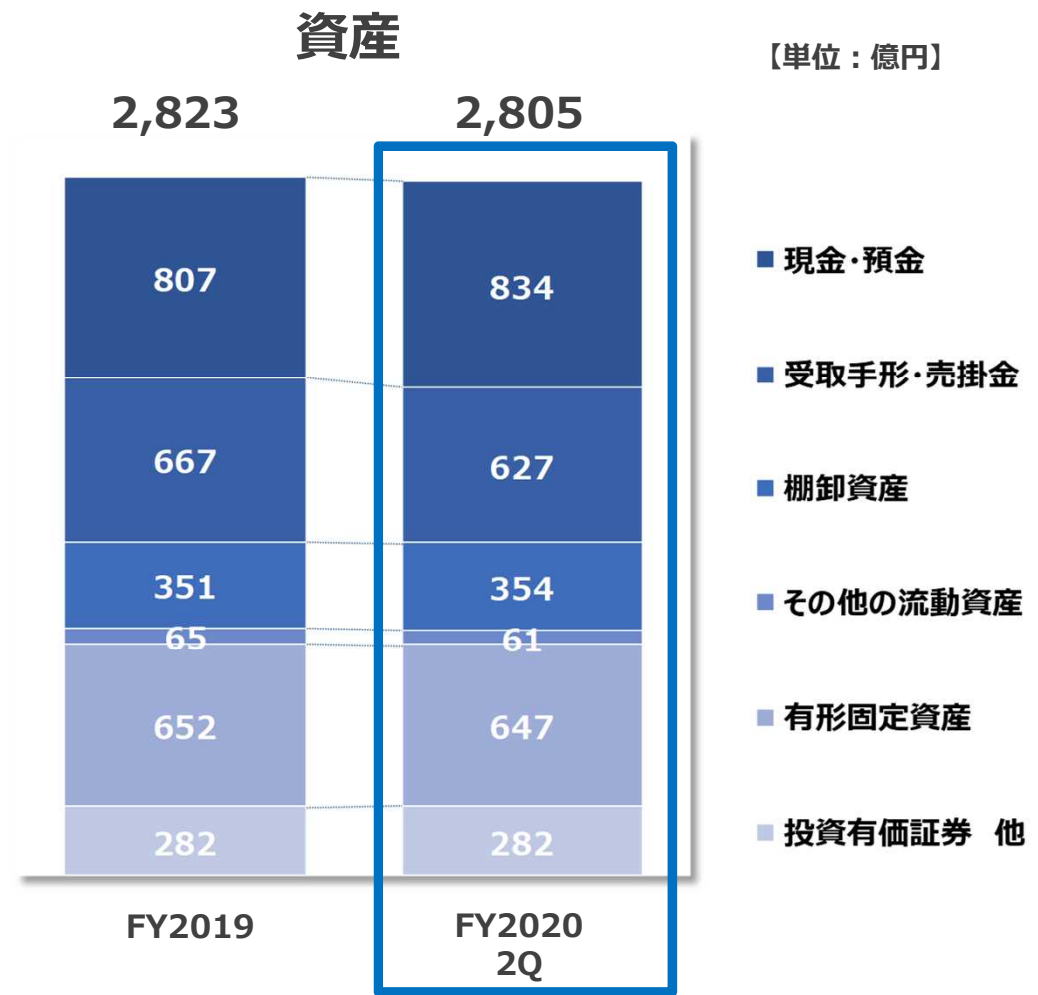
【単位：億円、%】



売上高

2020年度上期連結業績概要（連結貸借対照表）

- 受取手形・売掛金40億円減少、支払手形・買掛金5億円減少
- 純資産10億円増加、自己資本比率55.5%



市場見通しと取組み

■ 半導体

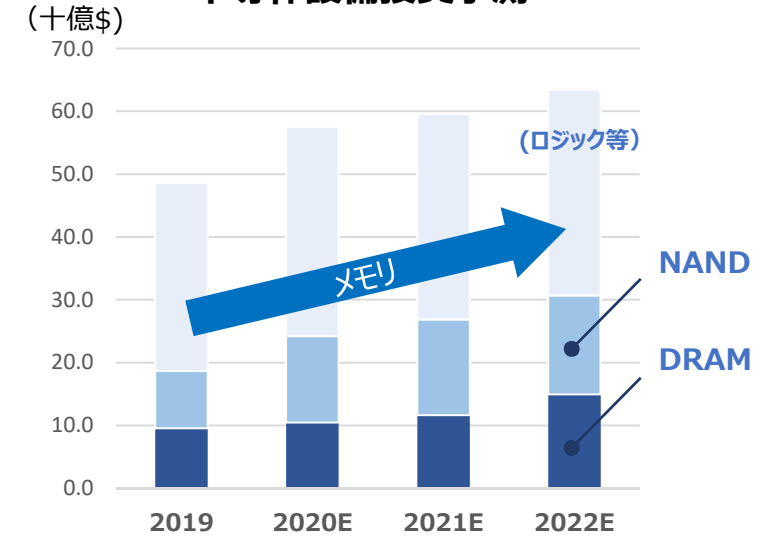
メモリ

- DRAM・NANDの投資再開で既存工程での受注増を見込む
- ロジック（MHM工程）の高評価から、DRAM等での共同開発も増加
⇒新規工程参入による受注増に注力
- PCRAM活用事例が広がるとともに、メモリメーカーの量産開発投資のすそ野も広がる

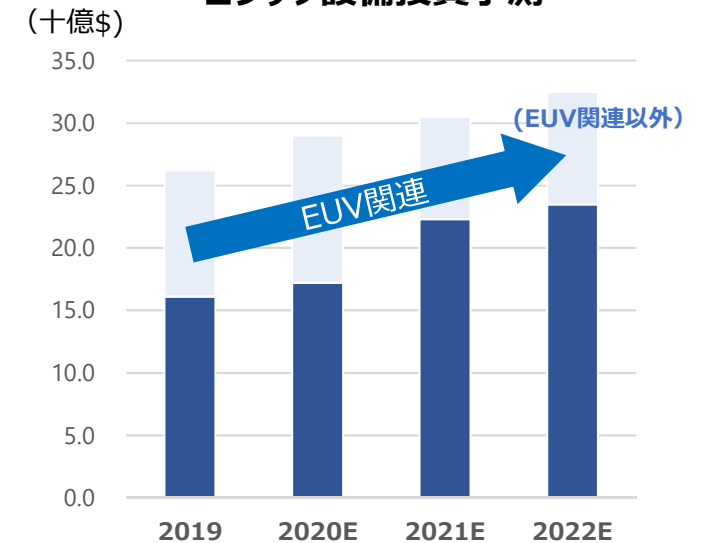
ロジック

- ロジックのMHM工程に参入でき既に複数社と取引
⇒更なる微細化でEUV工程増とともに受注増加見込み（1.7倍程度）
- セカンドベンダー期待から、ロジック別工程の共同開発にも取組み
⇒新規工程参入による受注増に注力

半導体設備投資予測



ロジック設備投資予測



市場見通しと取組み

■ 電子

- 上期は通信デバイス、オプトデバイス、パワーデバイス等の投資が日本・中国で活発化
- 特に中国は政府の国産化方針※もあり、パワーデバイスやAR/VR向けオプトデバイスを中心に投資計画が活発化
- 中国における技術営業体制強化・モジュール化による提案装置の幅拡大

※2021年1月29日工業情報化省が電子部品産業の発展行動計画＝国産化強化策を公表

パワーデバイス

- 日本はIGBT中心
- 中国は家電向け等ローエンドからミドル・ハイエンドを狙っていく方針でSiC向け商談が活発化。21年度から量産化・新工場建設増加見込み

オプトデバイス

- AR/VR向けオプトデバイスや車載用ディスプレイ向け投資が活発化
- 特に中国では幅広い分野で投資計画が進展中

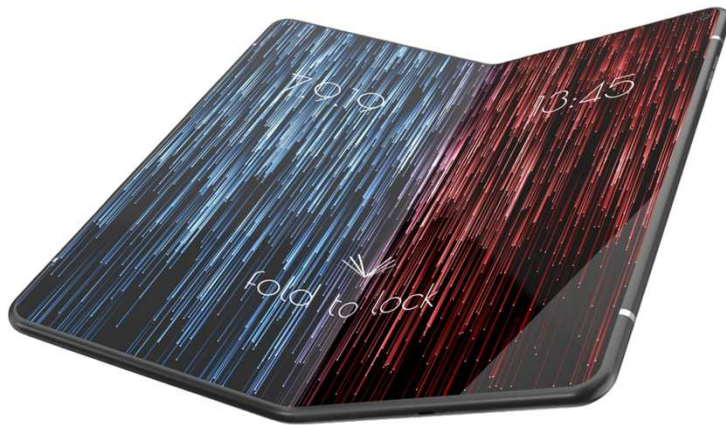
通信デバイス・MEMS

- 5Gに向けた通信関連、センサー等の投資が活発化
- 中国ではR&D投資中心（技術格差があり、本格投資には時間要）



■ FPD

- 今期は、スマートフォン用OLEDのバックプレーン用スパッタ装置・蒸着装置受注予定
⇒来期以降も投資継続見込み
- OLED投資は、スマートフォンに加え、TVやタブレット、ゲーム用モニター等向けの大型基板
OLED量産開発への取組も進む
- 大型TV用LCD投資も工場投資に加え、新型コロナウイルスに伴う巣ごもり需要（PC・大型
TV・ゲーム用モニター等）に対応する追加投資も受注。
⇒LCD投資については中国で継続投資の検討も進む



■ コンポーネント

- 自動車関連投資停滞の影響はあるが、半導体電子関連を中心に投資活発化の動きがみられ、段階的回復を見込む
- クライオポンプはOLED関連に加え、半導体電子分野の開拓にも力を入れる方針



■ マテリアル

- 新型コロナウイルスに伴う巣ごもり需要等もありFPD向けを中心に堅調に推移
- 得意とする粉末冶金で半導体電子向けビジネスの拡大を狙う



■ カスタマーサポート

- FPD関連のCIP・OLED用クライオポンプ関連等が増加傾向
- リモート型カスタマーサポートパッケージを開始



さまざまな業界・用途で貢献するアルバックの真空技術



Automobile
自動車



Semiconductor
半導体



Flat Panel Display
フラットパネルテレビ



Photovoltaic
太陽電池



Food Processing
食品



Aircraft
航空



Bio
バイオ



Smart Phone
スマートフォン



Magnetic Device
磁気デバイス



Home Appliance
家電製品



Aerospace
宇宙産業



Pharmaceutical
医療・薬剤



Wearable/VR
ウェアラブル/VR



Power Device
パワーデバイス



MEMS Device
MEMS デバイス



Architectural Glass
建材・スマートガラス



Optical
光学



Flexible
フレキシブル



Packaging Materials
パッケージング



Battery
バッテリー

真空テクノロジーで
「つくる」をつくる

ULVAC